

5G

スマートフォンのプリント基板分析 -断面観察-

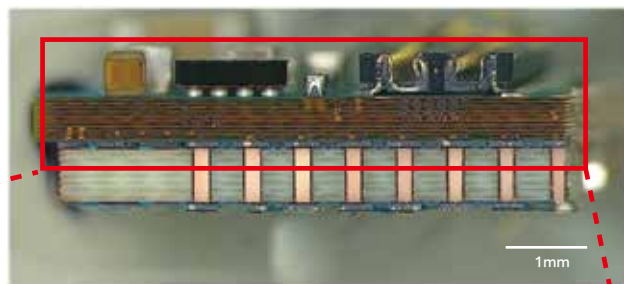
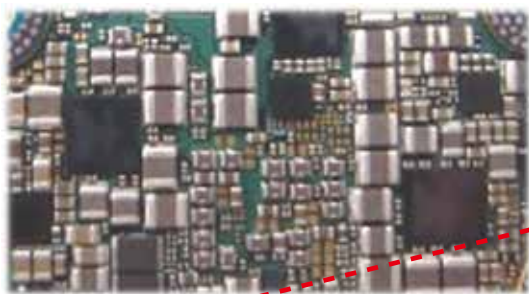
5Gでは高周波化に伴い、低誘電特性、耐熱性、寸法安定性、低吸水性、接着性(金属/樹脂、樹脂/樹脂)などがプリント基板に求められる。

耐熱性向上のためのフィラー添加、異種材接合などは断面観察することで多くの情報が得られる。ここでは5Gスマートフォン搭載のプリント基板の断面観察事例を紹介する。

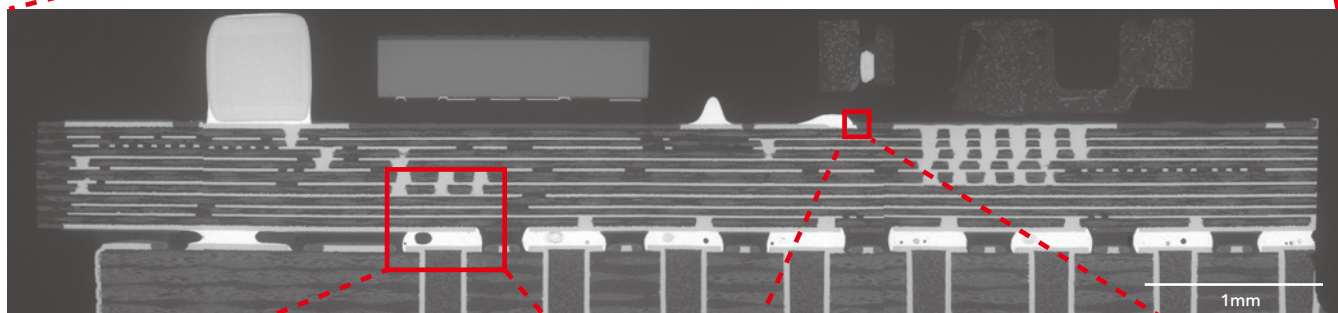
▶ プリント基板の断面観察

Cross-section Observation

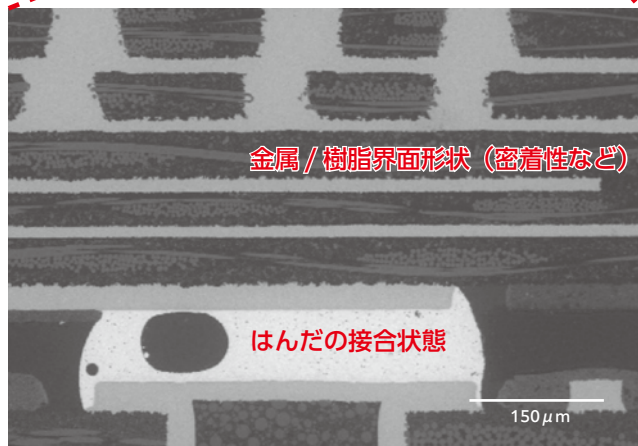
試料：市販5Gスマートフォン プリント基板



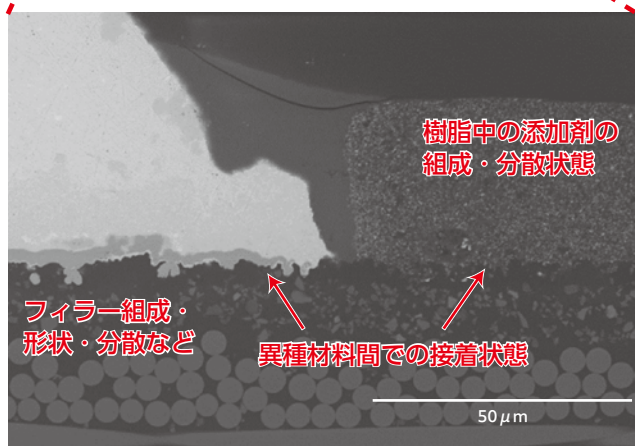
断面 OM 像



断面 SEM 像



断面 SEM 像 (拡大)



断面 SEM 像 (拡大)

